

Anmeldung per Fax: +49 711 685-83705,
oder on-line: [www.hahn-schickard.de/
anmeldung-mid-workshop/](http://www.hahn-schickard.de/anmeldung-mid-workshop/)

Hiermit melde ich mich zum Workshop "Visions to Products - MID and Beyond"
am 10. Oktober 2017 in Stuttgart an.

Teilnahmegebühr: 280,- EUR inkl. MwSt.

Name, Vorname, Titel:

Firma, Institut, Abt.:

Straße, Postfach:

Land, PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Hahn-Schickard
Allmandring 9 b
70569 Stuttgart

Datum:

Unterschrift:

Informationen

Termin: Dienstag, 10. Oktober 2017

Registrierung: 8:15 Uhr

Beginn: 9:00 Uhr

Ort: Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19, 70174 Stuttgart

Teilnahmebedingungen:

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Bitte melden Sie sich über folgende Website an: www.hahn-schickard.de/anmeldung-mid-workshop/
Alternativ können Sie für Ihre Anmeldung eine E-Mail mit allen Angaben auf dem Anmeldeabschnitt an Frau Bellezer (Carmen.Bellezer@Hahn-Schickard.de) senden oder diese Seite als Fax-Formular verwenden. Sie erhalten eine Rechnung, die gleichzeitig als Anmeldebestätigung gilt.

Teilnahmegebühr:

280,- EUR inkl. MwSt.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Mittagsbuffet, Pausengetränke und Workshop-Unterlagen. Wir behalten uns vor, bei einem Rücktritt innerhalb 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn eine Pauschale von 20% und innerhalb 8 Tagen die volle Teilnahmegebühr zu berechnen.

Allgemeine Hinweise:

Gemäß § 33 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir darauf hin, dass wir Ihre Anschrift in der Teilnehmerliste speichern.

Anreise:

www.hausderwirtschaft.de/anfahrt
Eingang: Willi-Bleicher-Straße 19

Kontakt:

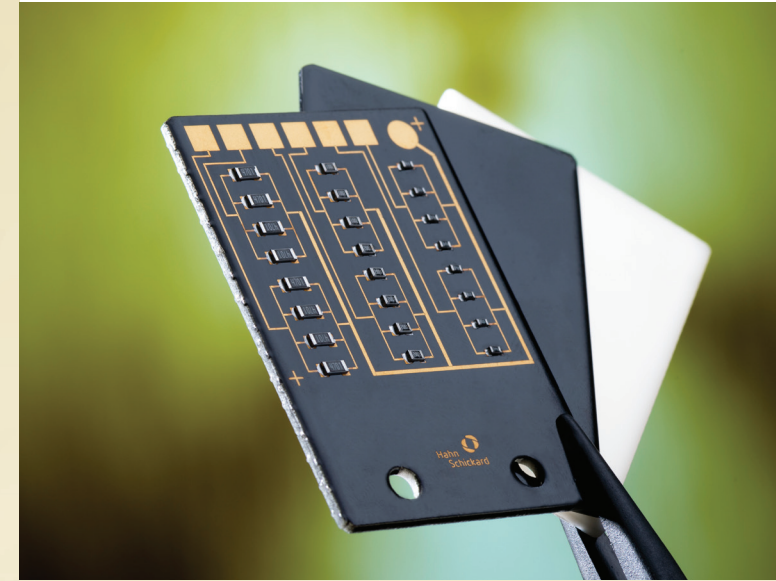
Carmen Bellezer

Telefon: +49 711 685-83712

Fax: +49 711 685-83705

E-Mail: Carmen.Bellezer@Hahn-Schickard.de

Workshop Visions to Products - MID and Beyond



10. Oktober 2017
in Stuttgart

Der Workshop

Der Workshop „Visions to Products – MID and Beyond“ setzt die Tradition der in zweijährigem Turnus von der Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. organisierten Veranstaltungsreihe zu innovativen Anwendungen von Molded Interconnect Devices (MID) fort.

Die diesjährige Veranstaltung beleuchtet, wie Technologien auf Basis von Foliensubstraten das Spektrum erweitern und im Kontext räumlicher Schaltungsträger sinnvoll eingesetzt werden können.

Einen wesentlichen Schwerpunkt des Workshops bilden innovative Anwendungen der MID-Technologie. Die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten wird durch applikationsorientierte Vorträge aus verschiedenen Industriezweigen anschaulich aufgezeigt. Abgerundet wird die Veranstaltung durch aktuelle Trends bzgl. neuer Technologien.

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg bietet Ihnen Hahn-Schickard ein spannendes Programm mit Referenten aus Industrie und industrienaher Forschung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Prof. Dr.-Ing. André Zimmermann

Programm

8:15 Registrierung

9:00 Eröffnung und Einführung

Prof. A. Zimmermann,
Universität Stuttgart ifm und Hahn-Schickard

9:15 Foliensysteme

Smart Wave Panel

C. Ernst, Kunststoff Helmbrechts AG

Flexible and Stretchable PCBs for Smart Electronics

J. Kostelnik, Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Smarte elektronische Systeme auf Folienbasis

T. Meißner, Hahn-Schickard

10:30 Kaffeepause

11:00 Applikationen

MID-basierender Strömungssensor mit selbst-kompensierendem Temperaturverhalten

C. Hepp, Innovative Sensor Technology IST AG

MID Projektvorstellung

N. Bachnak, Multiple Dimensions AG

Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung

T. Grözinger, Hahn-Schickard

12:15 Mittagspause

13:30 Applikationen

Biomedical Sensor Development Utilizing MID Technology

S. I. Hansen, Sensocure as

From Pixels to Trixels: Glasses-free 3D Billboards

J. Reitterer, TriLite Technologies GmbH

MID for Space

K. Ruzicka, Art of Technology AG

3D Leiterbahnen für ITER Bolometersensoren

H. Meister, Max-Planck-Institut f. Plasmaphysik

15:10 Kaffeepause

15:40 Neue Technologien

Direktumspritzung - Anwendungen vom Wegwerfartikel bis zur autoklavierbaren elektronischen Baugruppe

V. Callegari, Turck duotec S.A.

Laser Pigments for Additive Manufacturing and Prototyping for 3D MIDs

S. Rosenberger, Merck KGaA

Rapid Prototyping von MID durch Additive Fertigung und Laserlöten

H. Müller, Hahn-Schickard

Schlusswort

17:00 Ende des Workshops

Gefördert durch:



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU